



APEXX A3

クラス最高レベルのCPU周波数とマルチコアにより、要求の厳しい3Dコンテンツ制作、レンダリング、ビジュアライゼーション、シミュレーションを高速化する多用途な液冷式APEXX A3は、5.7GHzで動作するAMD Ryzen™ 9000シリーズプロセッサ、最大2基のプロフェッショナルGPU、オールメタルシャーシに収められたプレミアムコンポーネントを搭載し、米国で設計、製造、サポートされています。

AMD RYZEN

主な特徴

AMD Ryzen™ 9000シリーズ 16コアプロセッサを搭載

プロフェッショナルグレードのNVIDIA®グラフィックス、NVIDIA® GeForce™グラフィックス、またはAMD® Radeon Pro™グラフィックスを搭載

デジタルコンテンツ制作やその他のプロフェッショナルアプリケーション向けに、世界最高レベルのマルチスレッド性能を実現

筐体素材

アメリカ国内で製造されたプロフェッショナルグレードのアルミニウムシャーシを採用

サービス & サポート

3年間センドバック
ピックアップサービス
オンサイト修理

チップセット:
AMD X870E

ソケット:
シングル (AM5)

CPU冷却:
水冷 (簡易水冷/クローズドループ)

プロセッサ:
AMD Ryzen 9000

コア動作周波数:
ベース 4.3GHz / ブースト 5.7GHz

コア/スレッド数:
16コア / 32スレッド

マルチスレッディング:
対応

最大構成可能メモリ:
192GB

DIMMスロット数:
4

物理PCIeスロット:
x16, x16(x8動作)

GPUあたりのPCIeレーン:
最大2枚のGPUまでx16動作に対応

M.2ドライブ:
2スロット (各最大4TB)

U.2サポート:
対応

RAIDサポート:
0, 1, 10

OCuLinkサポート:
非対応

最大2.5インチ / 3.5インチ構成:
3.5インチ × 2基 / 3.5インチ × 1基 + 2.5 × 2基 /
2.5インチ × 4基

オンボードWi-Fi:
802.11ab (Wi-Fi 7)

オンボードBluetooth:
V5.2

電源ユニット:
750W

筐体寸法:
幅: 17.37cm (6.84")
高さ: 38.81cm (15.28")
奥行: 45.21cm (17.80")

フロント I/O:
USB 3.2 Gen 1 Type A × 2
USB 3.2 Gen 2 Type C × 1
オーディオ出力 / マイク入力

リア I/O:
5 Gigabit LAN (RJ-45) × 1
USB 4.0 (USB Type-C) × 2
USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 3
USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 5
7.1-Channel HD Audio
Optical SPDIF Out × 1
Antenna × 2
HDMI × 1

光学ドライブ:
なし

ラックマウントオプション:
なし

表示されているCPUコア数とクロック速度は最大です。コア数や周波数が異なるプロセッサも選択可能です。GPUの消費電力は控えめな推定値です。出荷重量は構成によって異なります。

BOXX

